光電子収率分光法による SiO₂/SiC 構造の電子状態計測(2)

Electronic States at Ultrathin SiO₂/SiC Interface

Measured by Total Photoelectron Yield Spectroscopy (2)

¹名大 VBL, ²名大院エ ⁰¹大田 晃生, ²渡邊 浩成, ²グェンスァンチュン, ²牧原 克典, ²宮崎 誠一

¹Nagoya Univ. VBL, ²Nagoya Univ., ⁰¹Akio Ohta, ²Hiromasa Watanabe, ² Nguyen Xuan Truyen,

²Katsunori Makihara, and ²Seiichi Miyazaki

E-mail: a_ohta@nuee.nagoya-u.ac.jp

序>前回、希釈 HF 処理した 4H-SiC 表面において高濃度の表面準位が残留し、熱酸化後ではミッドギャップよりも伝導帯側に電子占有欠陥準位が増大することを光電子収率分光(PYS: Total Photoelectron Yield Spectroscopy[1])により明らかにした[2]。今回、Wet 酸化により形成した SiO₂/4H-SiC 構造の電子占有欠陥の深さ方向分布を評価した結果を報告する。

実験>n型4H-SiC(0001)ウェハを化学溶液洗浄した後、1080℃のWet酸化により厚さ7.6nmおよび21.8nmのSiO₂を成長した。深さ方向分析のため、希釈HF溶液浸漬によるSiO₂の薄膜化とPYS 測定(入射エネルギ範囲: 3.4~5.6eV)を繰り返し行った。

結果及び考察>厚さ 21.8nm の SiO₂膜を薄膜化の各過程で測定した PYS スペクトルを Fig.1 に示 す。図中に示した薄膜化後の SiO₂膜厚は、別途行った XPS 測定の Si2p 内殻光電子信号から算出 した。PYS では、4H-SiC の電子親和力(3.65eV)およびバンドギャップ(Eg: 3.25eV)を考慮すると、 伝導帯下端(Ec)からミッドギャップ(Ei)に相当するエネルギ領域を測定し、観測された光電子収率 は主として Eg 中に存在する電子占有欠陥に起因する。SiO₂膜厚が 21.8nm および 7.9nm の PYS ス ペクトルでは、光電子収率に明瞭な変化は認めらないものの、3.1nm まで SiO₂を薄膜化すると入 射エネルギが 4.0eV 付近の光電子収率が顕著に増大する。さらに、SiO₂を希釈 HF 処理により薄 膜化することで、光電子収率は大きく減少することから、SiO₂/4H-SiC 界面近傍の SiO₂層内に電 子占有欠陥の偏在していることが明らかになった。このときミッドギャップ近傍(5.27eV)の光電子 収率に大きな膜厚依存性は認められない。さらに、厚さ 7.6nm SiO₂の試料に対しても同様の測定 を行い、入射エネルギ 4.0eV で観測された光電子収率を SiO₂膜厚に対してまとめた(Fig.2)。SiO₂ 膜厚が 7.8nm および 21.8nm のどちらの試料においても、4H-SiC 表面から 2~3nm 付近で、光電子 収率が大きく増大する領域が存在することが分った。また、SiO₂膜厚が 21.8nm の試料では、7.6nm の試料に比べ、界面近傍の電子占有欠陥が増大する傾向が認められた。

結論>熱酸化 SiO₂/4H-SiC 構造において、ミッドギャップよりも伝導帯側に存在する電子占有欠 陥がSiO₂膜厚に対して大きく分布し、特に4H-SiC表面から2~3nm付近で増大することが分った。 謝辞>本研究の一部は、名古屋大学ベンチャービジネスラボラトリーを利用して行った。

文献>[1] S. Miyazaki, et al., Microelectro. Eng., 48 (1999) 63. [2] 大田 他、2014 年 第 75 回応用物 理学会秋季学術講演会, 18p-A17-2, 15-247.



10 (A.U.) Initial PHOTOELECTRON YIELD SiO₂ Thickness 10² 21.8nm 10¹ 7.6nm Photon Energy :4.0eV 100 20 15 10 Remiained SiO₂ Thickness (nm)

Fig.1 Total photoelectron yield spectra taken with progressive oxide thinning of thermally grown $SiO_2/4H$ -SiC structure with an initial SiO_2 thickness of 21.8nm. In the oxide thinning, a 0.1% HF solution was used.

Fig. 2 Changes in the photoelectron yield intensity at an incident photoenergy of 4.0eV for thermally grown SiO₂/4H-SiC structure as a function of remained SiO₂ thickness.